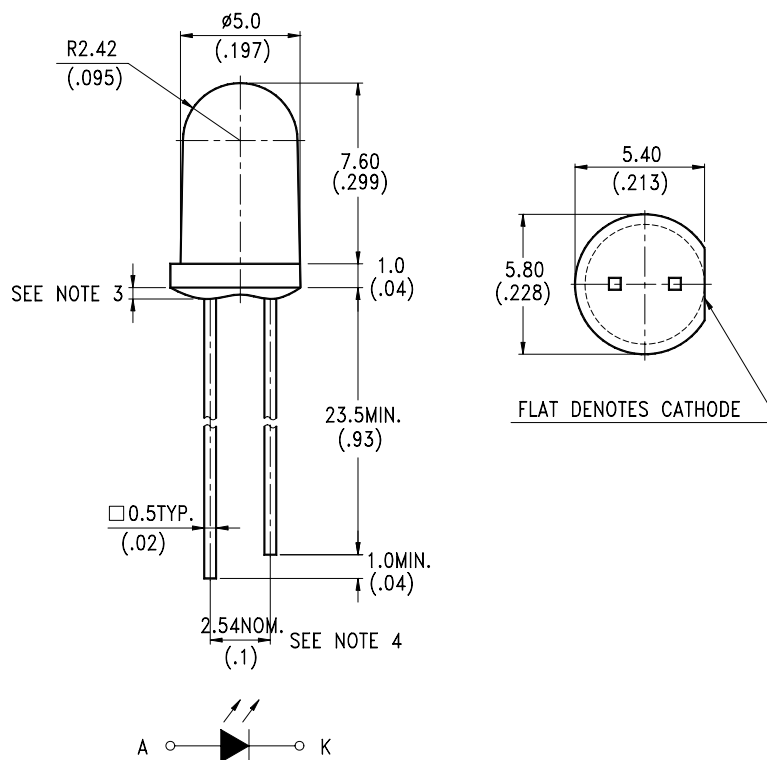


FEATURES

- * SPECIAL FOR HIGH CURRENT AND LOW FORWARD VOLTAGE
- * HIGH POWER
- * AVAILABLE FOR PULSE OPERATING
- * WIDE VIEWING ANGLE

PACKAGE DIMENSIONS**NOTES:**

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25\text{mm}$ (.010") unless otherwise noted.
3. Protruded resin under flange is 1.5mm (.059") max.
4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
5. Specifications are subject to change without notice.



LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION.

Property of Lite-On Only

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT TA=25

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation	150	mW
Peak Forward Current (300pps, 10 μ s pulse)	2	A
Continuous Forward Current	100	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-40 to + 85	
Storage Temperature Range	-55 to + 100	
Lead Soldering Temperature [1.6mm(.063") From Body]	260 for 5 Seconds	

ELECTRICAL OPTICAL CHARACTERISTICS AT TA=25

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION	BIN GRADE
Aperture Radiant Incidence	Ee	1.12			mW/cm ²	IF = 20mA	BIN D
Radiant Intensity	IE	8.42			mW/sr	IF = 20mA	BIN D
Peak Emission Wavelength	P		940		nm	IF = 20mA	
Spectral Line Half-Width			50		nm	IF = 20mA	
Forward Voltage	VF		1.25	1.6	V	IF = 50mA	
Forward Voltage	VF		1.85	2.3	V	IF = 500mA	
Reverse Current	IR			100	μ A	VR = 5V	
Viewing Angle (See FIG.6)	2 1/2		50		deg.		

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES

(25 Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

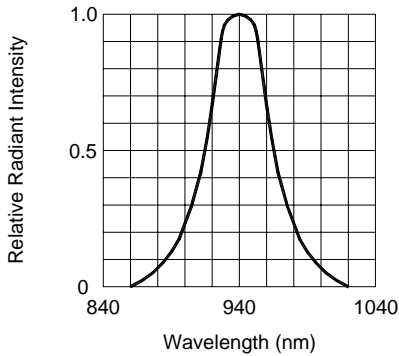


FIG.1 SPECTRAL DISTRIBUTION

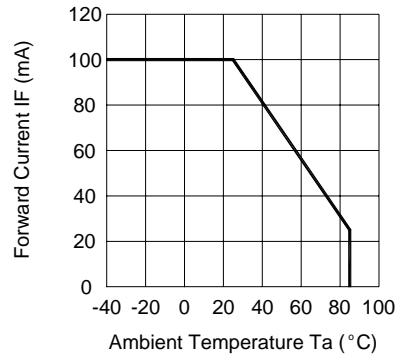


FIG.2 FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

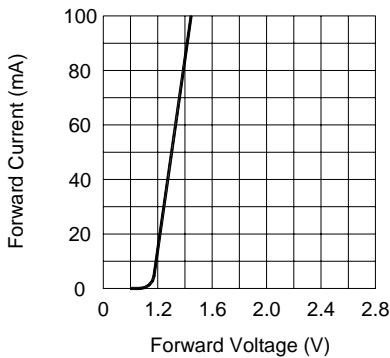


FIG.3 FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

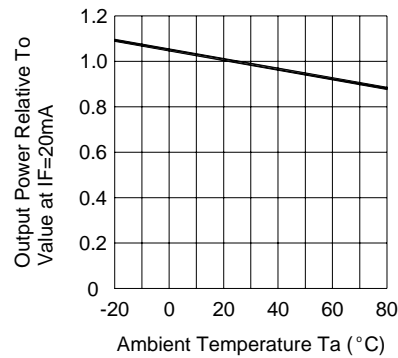


FIG.4 RELATIVE RADIANT INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE

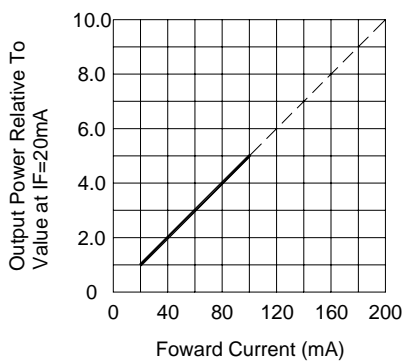


FIG.5 RELATIVE RADIANT INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

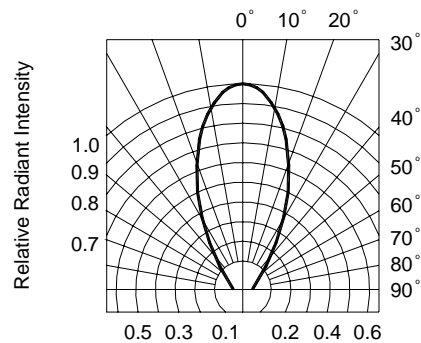


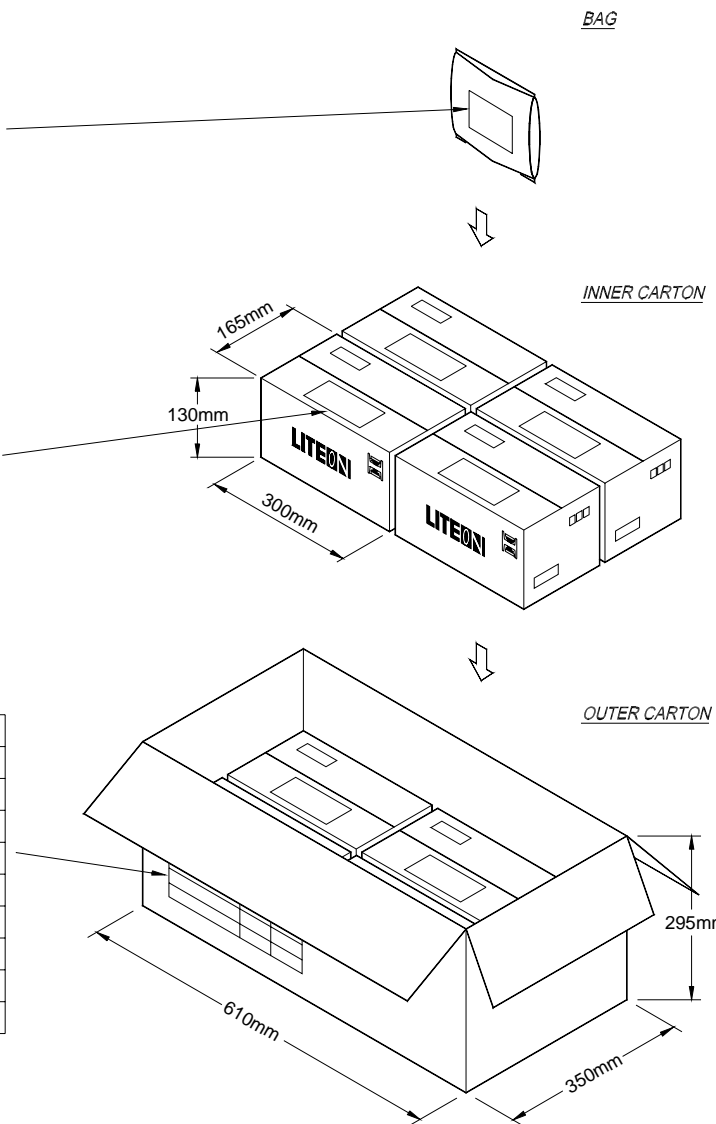
FIG.6 RADIATION DIAGRAM

PACKING

LITEON	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	
CUSTOMER:	_____
DEVICE TYPE:	LTE-3271B
BIN GRADE:	_____
LOT NO.:	_____
Q'TY:	_____
RMK:	_____

CUSTOMER	:	_____
CUSTOMER P/N:	:	_____
DEVICE TYPE	:	LTE-3271B
BIN	:	_____
COLOR RANK	:	_____
QUANTITY	:	_____
Q. C STAMP	:	_____

DIVICE NO.	BIN	QUANTITY
LTE-3271B		
Q.C STAMP		



Bag volume (pcs / Bag)	Inner carton volume (Bag / carton)	Outer carton volume (Box / Carton)	Total volume (pcs/outer carton)
1000	8	8	64000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.